

证券代码：688809

证券简称：强一股份

公告编号：2026-011

强一半导体（苏州）股份有限公司 关于公司与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员 会签订投资协议书（二）暨对外投资进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次投资概述

强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会于2023年3月21日就半导体产品、集成电路测试探针卡、集成电路陶瓷基板及器件等产品的研发、生产和销售项目签订《投资协议书》（以下简称“原投资协议”）和《投资补充协议》，并在苏锡通科技产业园区设立全资子公司强一半导体（南通）有限公司（以下简称“项目公司”）实施整个项目的投资、建设和运营。该项目分为一期和二期，为优化资源配置，公司于2025年12月10日召开了第二届董事会第五次会议、于2025年12月25日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于与苏锡通科技产业园区管理委员会签署<投资协议书（二）>的议案》，同意公司将原投资协议约定的二期项目分成2-1、2-2期逐步推进实施，并与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会就投资建设2-1期项目签订《投资协议书（二）》。

二、对外投资进展情况

2026年2月2日，公司与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会就投资建设2-1期项目签订了《投资协议书（二）》，协议主要内容如下：

(一) 协议各方

甲方：江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会

乙方：强一半导体（苏州）股份有限公司

(二) 投资项目基本情况

1、项目内容：集成电路玻璃基板及器件的研发、生产和销售。

2、项目投资：总投资不低于 7.5 亿元，其中固定资产投资（不含土地）不低于 6.5 亿元，固定资产投资中设备投资不低于 4 亿元。乙方承诺新增注册资本 1.5 亿元，最迟不晚于 2026 年 3 月 15 日完成注册资本工商变更；并在领取变更注册资本的营业执照之日起 3 个月内，该部分新增的注册资本到账 3000 万元，剩余部分在项目公司领取营业执照之日起 5 年内到账。

3、项目进程：2-1 期项目自本协议签署之日起 2 个月内完成含效果图在内的总平方案设计，并通过审批部门组织的评审，同时提交符合要求的土地挂牌材料；自土地挂牌公告之日起 2 个月内一次性全面开工建设，整体项目于在开工后 2 年内建成并投产。

4、项目地址：园区海宾路以北，江海大道以东，江港路以南。

5、用地面积：合计约 55 亩（具体面积以实测面积为准）。

(三) 双方的主要权利和义务

甲方为乙方投资提供一站式服务，协助乙方办理工商变更、项目审批、规划建设等方面的相关证照。证照办理进度应与乙方项目实施同步，不因此影响项目推进及生产经营；乙方及项目公司需按甲方要求时限，提供办理手续所需文件资料。

(四) 其他约定

1、本协议经甲乙双方盖章及甲乙双方合法授权人签字生效。

2、本协议书与双方于 2023 年 3 月 21 日签署的《投资协议书》及《投资补充协议》共同组成完整的协议，为双方主张权利义务的合同依据，具有同等法律效力。如三份协议内容不一致的，以本协议内容为准或双方另行协商确定。

三、本协议的签署及对外投资对公司的影响

本次 2-1 期项目《投资协议书（二）》的签订，是公司落实原有投资规划、优化项目实施节奏的重要举措，分期推进项目可有效降低实施风险，实现资源精准投放，确保项目建设质量与效率。

本次投资计划使用公司自有资金或其他自筹资金，短期内公司将面临一定的资金投入压力，可能导致货币资金减少、投资活动现金流出增加。长期来看，随着项目逐步建成并投入运营，将逐步释放产能、产生经营收益，为公司带来稳定的营业收入和利润增长点，提升盈利能力与资产回报率。公司将合理规划资金使用节奏，确保项目建设和日常经营正常运行。本次投资不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

（一）项目审批与合规风险

项目建设需取得建设项目核准或备案、环境影响评价、节能评估、安全生产评价报告等资质。若上述审批流程受阻，或相关资质无法顺利获取，项目实施进度将面临不确定性，存在延期或停滞的风险。

（二）土地获取风险

本项目投资及建设以竞得目标土地使用权为前提，土地获取需符合国家供地政策，并通过“招标、拍卖、挂牌”等公开方式取得。土地使用权竞得结果、最终成交价格及时间均存在不确定性，可能影响项目启动条件。

（三）投资规模与审批风险

项目投资规模为初步计划数，最终以政府备案和审批的金额为准。公司郑重提示投资者，投资决策应基于理性分析，充分关注投资规模调整可能带来的风险。

（四）外部环境与项目调整风险

项目投资与建设将受国家产业政策、市场供需、行业竞争及技术进步等多重因素影响，可能导致投资金额和建设内容调整。

（五）资金筹措与偿债风险

项目投资金额较大，公司将分阶段投入资金，并已规划通过自有资金、银行贷款等渠道解决资金需求。虽已充分考虑资金筹措方案，但存在资金到位不及时的风险。若通过银行贷款筹资，项目若未达预期经济效益，公司将面临较大偿债压力。

公司将积极落实本协议的约定事项，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026年2月4日